公司代码：688981　　公司简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

三、本公司董事会及董事和高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交 2024 年股东周年大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

一、公司简介

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

（三）联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郭光莉	聂捷涵
办公地址	中国上海市浦东新区张江路 18 号	中国上海市浦东新区张江路 18 号
电话	021-20812800	021-20812800
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。

除集成电路晶圆代工外，集团亦致力于打造平台式的生态服务模式，为客户提供设计服务与 IP 支持、光掩模制造等一站式配套服务，并促进集成电路产业链的上下游协同，与产业链中各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

（二）主要经营模式

1.盈利模式

公司主要从事基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与 IP 支持、光掩模制造等配套服务。

2.研发模式

公司具备完整、高效的创新机制，完善的研发流程管理制度和专业的研发团队，推进应用平台的研发，进一步夯实技术基础，构建技术壁垒。公司的研发流程主要包括七个阶段，即项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产，每个阶段均有严格的审批流程，从而确保研发项目的成功转化。

3.采购模式

公司主要向供应商采购集成电路晶圆代工及配套服务所需的物料、零备件、设备、软件及技术服务等。为提高生产效率、加强成本控制，公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系与较为完善的供应链安全体系，建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制，在与主要供应商保持长期合作关系的同时，兼顾新供应商的导入与培养，加强供应链的稳定与安全。

4.生产模式

公司按市场需求规划产能，并按计划进行投产，具体如下：

(1)小批量试产：客户按照公司提供的设计规则进行产品设计。设计完成后，公司根据客户的产品要求进行小批量试产。

(2)风险量产：小批量试产后的样品经封装测试、功能验证等环节，如符合市场要求，则进入风险量产阶段。风险量产阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等。

(3)批量生产：风险量产阶段完成且上述各项交付指标达标后，进入批量生产阶段。在批量生产阶段，销售部门与客户确认采购订单量，生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。

5.营销及销售模式

公司采用多种营销方式，积极通过各种渠道拓展客户。在与客户建立合作关系后，公司与客户直接沟通并制定符合其需求的解决方案。

公司通过市场研究、主动联系并拜访目标客户，推介与客户匹配的工艺和服务，进而展开一系列的客户拓展活动。公司通过与设计服务公司、IP 供应商、EDA 厂商、封装测试厂商、行业协会及各集成电路产业促进中心合作，与客户建立合作关系。公司通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各种专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户。部分客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司销售团队与客户签订订单，并根据订单要求提供集成电路晶圆代工以及相关配套服务，制造完成的产品最终将被发货至客户或其指定的下游封装、测试厂商。

公司结合市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素，形成了目前的晶圆代工模式。报告期内，上述经营模式的关键因素未发生重大变化。

（三）所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2023 年，全球宏观经济仍处于下行周期。半导体周期与全球经济周期具有较高的相关性，智能手机和个人电脑等需求减弱、半导体行业经历结构性供需调整。全球半导体库存的消耗速度整体慢于各产业环节的生产和采购速度，芯片库存仍处于高位。2023 年下半年，伴随手机、穿戴类设备、个人电脑、智能应用等新品发布，以及宏观经济回暖预期，行业逐步显现复苏迹象。

半导体产业面对的下游行业范围较广，各细分应用领域的复苏周期存在一定的差异。从产品大类来看，存储芯片是 2023 年半导体市场下行的主要领域，而逻辑、模拟、光电、传感、分立器件领域的需求下降幅度相对有限。伴随一些先导产业对智能化和自动化应用的推广，一些细分领域的需求不降反升，成为晶圆代工企业逆势增长的机遇。

从地域上看，近年来半导体的地域化发展趋势逐年明显。半导体行业本土化发展的动力主要来自本土市场需求的规模化及本土经济发展的韧性。从中国大陆的产业情况看，作为全球最大的半导体消费市场之一，现阶段我国集成电路产业仍一定程度地依赖进口。国内现有集成电路产业规模、包括晶圆代工产能规模、工艺技术能力、与实际市场需求仍不匹配。随着新一轮科技创新的推动，国内产业链具备较大的成长空间。

从行业特点看，晶圆代工行业仍然是半导体产业链前端的关键行业，具备高度的技术密集、人才密集和资金密集的特点。晶圆代工的运营过程对生产环境、能源、原材料、设备和质量体系等有非常严格的管理和执行规范，其研发和制造过程涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科，立足专业的技术团队与强大的研发能力，以及对工艺进行整合集成的工程能力，行业的技术门槛极高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2023 年销售额情况排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，晶圆代工企业多以技术领先性、平台多样性、性能差异化作为吸引客户的核心优势。随着市场需求更趋多元化，企业在纵向追求更小的晶体管结构的同时，也更注重利用量产工艺节点的性能基础开展横向的衍生平台建设，以满足庞大的终端市场的差异化需求。

与此同时，各类新型封装、设计服务以及光掩模等技术持续突破，为晶圆代工技术迭代赋能。在新型封装技术领域，各类形式的系统性解决方案有效地突破了晶体管线宽极限并进一步提高了多芯片集成的融合度；在设计服务领域，DTCO（Design Technology Co-Optimization，设计工艺协同优化）对具体设计和工艺匹配作评估和调整，有效地降低了半导体工艺开发的成本和使用风险；光掩模作为集成电路制造产业链上的核心关键工具，其掩模工艺和介质材料不断进化，进一步提升设计图形光刻的工艺表现。

伴随全球行业格局的变化，晶圆代工企业在专注自身工艺技术与平台建设的同时，也愈加重视产业生态布局，其产能规模效应和在地化的产业链协同能力已成为客户衡量供应链稳定性和完整性的重要因素之一。

从未来发展趋势看，晶圆代工企业通过持续拓展产能规模、新工艺研发，加强产业链协同等方式不断强化资本、技术和行业生态壁垒，少数企业占据市场主导地位的业态将长期存在，行业头部效应将愈加明显。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	338,463,197	305,103,691	10.9	229,932,806
归属于上市公司股东的净资产	142,475,834	133,371,921	6.8	109,198,772
营业收入	45,250,425	49,516,084	-8.6	35,630,634
归属于上市公司股东的净利润	4,822,814	12,133,079	-60.3	10,733,098
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,269,518	10,133,988	-67.7	5,655,839
经营活动产生的现金流量净额	23,047,761	36,591,209	-37.0	20,844,994
加权平均净资产收益率(%)	3.5	10.0	减少 6.5 个百分点	10.3
基本每股收益(元/股)	0.61	1.53	-60.1	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.53	-60.1	1.35
研发投入占营业收入的比例(%)	11.0	10.0	增加 1.0 个百分点	11.6

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	10,208,898	11,108,892	11,780,454	12,152,181
归属于上市公司股东的净利润	1,591,324	1,405,941	677,519	1,148,030
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	933,444	831,454	689,947	814,673
经营活动产生的现金流量净额	5,300,145	5,653,162	5,394,219	6,700,235

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据 2023 年 12 月 22 日最新公布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，本公司重述本年度第一季度至第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

四、股东情况

（一）普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)(1)	244,046
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)(2)	248,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

附注：

(1) 截至本报告期末，注册股东户数 244,046 户中：A 股 232,065 户，港股 11,981 户。

(2) 截至 2024 年 2 月 29 日，注册股东户数 248,000 户中：A 股 236,040 户，港股 11,960 户。

（二）截至报告期末前十名股东持股情况表

1. 截至本报告期末，本公司于香港已发行 5,972,946,588 股，约占本公司总股本 75.2%，于上交所科创板已发行 1,973,609,172 股，约占本公司总股本 24.8%。

2. 本公司香港股东名册由 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中 HKSCC NOMINEES LIMITED 代非登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.8%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.2%。

3. 根据香港证券及期货条例，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的股东需自行进行权益申报。根据股东权益申报情况，大唐香港持有港股 1,116,852,595 股及鑫芯香港持有港股 617,214,804 股。公司已将前述股东所持股份数目从 HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份数目中剔除。

4. A 股股东性质按照中国结算 A 股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	17,906,414	4,226,937,558	53.19	—	—	未知	—	未知
大唐投股(香港)投资有限公司	-	1,116,852,595	14.05	—	—	无	—	境外法人
鑫芯(香港)投资有限公司	-	617,214,804	7.77	—	—	无	—	境外法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	100,762,427	208,352,114	2.62	—	—	无	—	其他
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	-	127,458,120	1.60	—	—	无	—	其他
中国信息通信科技集团有限公司	-	72,470,855	0.91	—	—	无	—	国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	20,765,258	55,510,389	0.70	—	—	无	—	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,902,607	46,571,769	0.59	—	—	无	—	其他
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,584,237	33,435,738	0.42	—	—	无	—	其他
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	4,516,804	25,060,036	0.32	—	—	无	—	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.大唐香港为中国信科的全资子公司。 2.鑫芯香港为国家集成电路基金的全资子公司。 3.国家集成电路基金的董事楼宇光、唐雪峰、严列秋、王文莉同时担任国家集成电路基金二期的董事，监事林桂凤、平丽同时担任国家集成电路基金二期的监事；董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监事。 4. 华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路基金、国家集成电路基金二期进行管理。 5.国家集成电路基金和国家集成电路基金二期有部分相同股东。 除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

（三）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

（五）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

（六）报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团实现营业收入人民币 45,250.4 百万元，比上年同期减少 8.6%；实现净利润人民币 6,396.2 百万元，比上年同期减少 56.4%。报告期内，本集团的经营活动所得现金净额为人民币 23,047.8 百万元，较上年同期减少 37.0%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 53,865.1 百万元，较上年同期增加 27.6%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A 股代码：688981　　A 股简称：中芯国际　　公告编号：2024-007

港股代码：00981　　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）2024 年 3 月 28 日董事会书面决议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，全体董事一致同意该议案。

根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《关联（连）交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计额度约为 649,168 千元，具体情况如下：

单位：人民币千元

关联人	关联交易类别	2024 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	采购货物	460	-	426	32	0.0	/
	接受劳务	300	0.1	-	929	0.2	/
	向关联方出租资产	2,291	1.3	532	5,008	2.9	/
	向关联方买入机器设备	33,950	0.2	8,854	130,165	0.6	/
	小计	37,001	/	9,812	136,134	/	/
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	接受劳务	2,406	7.9	438	5,265	9.7	/
	向关联方出租资产	3,727	3.7	157	6,040	3.5	/
	小计	6,133	/	595	11,305	/	/
凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司（原“凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司”）	采购货物	52,329	0.4	13,538	30,240	0.2	/
	向关联方出租资产	33,705	19.4	6,757	33,519	19.3	/
	小计	86,034	/	20,295	63,759	/	/
灿芯半导体（上海）股份有限公司	销售货物	520,000	1.3	91,738	433,673	1.1	/
总计		649,168	/	122,440	644,871	/	/

注 1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

注 2：上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

注 3：上表中需说明金额差异较大原因的标准为差异金额占公司最近一期经审计总资产 0.1%以上。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币千元

关联人	关联交易类别	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额
盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	采购货物	220	32
	接受劳务	1,500	929
	向关联方出租资产	2,650	5,008
	向关联方买入机器设备	165,000	130,165
	向关联方卖出机器设备	2,100	-
	小计	171,470	136,134
中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	接受劳务	4,375	5,265
	向关联方出租资产	5,701	6,040
	小计	10,076	11,305
凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司（原“凸版中芯彩晶电子（上海）有限公司”）	采购货物	32,148	30,240
	向关联方出租资产	29,556	33,519
	小计	61,704	63,759
灿芯半导体（上海）股份有限公司	销售货物	678,000	433,673
总计		921,250	644,871

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司

公司名称	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司
公司性质	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	项习飞
注册资本	12,222.0052 万美元
成立日期	2018 年 3 月 22 日
住所/主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村
主营业务	半导体设备的研发、生产、销售和相关技术服务；半导体设备及配件的翻新改造安装维护销售等
主要股东或实际控制人	天津吉盛管理咨询合伙企业（有限合伙）；持股比例 10.64% 中芯国际控股有限公司；持股比例 8.32% 宁波芯空间融芯创业投资合伙企业（有限合伙）；持股比例 7.47% TRIPLECORES KOREA CO.,LTD.；持股比例 6.93% 上海新阳半导体材料股份有限公司；持股比例 5.91%

2.中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司

公司名称	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	高永岗
注册资本	10,000 万人民币
成立日期	2014 年 2 月 27 日
住所/主要办公地点	上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 337 室
主营业务	股权投资管理，投资管理
主要股东或实际控制人	上海芯齐投资中心（有限合伙）；持股比例 35.00% 中芯国际集成电路新造（上海）有限公司；持股比例 19.51% 宁波道至丰投资管理有限公司；持股比例 17.50% 宁波月潮香庄文化发展有限公司；持股比例 17.50% 芯空间投股有限公司；持股比例 10.49%

3.凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司

公司名称	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司
公司性质	有限责任公司（外商合资）
法定代表人	植木智朗
注册资本	6,400 万美元
成立日期	2004 年 11 月 24 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张江路 18 号 2 号楼 1 楼
主营业务	成像传感器的设计，晶圆彩膜及微型镜头的设计、生产、加工
主要股东或实际控制人	凸版印刷株式会社（日本）；持股比例 70% 中芯国际集成电路制造有限公司；持股比例 30%

4.灿芯半导体（上海）股份有限公司

公司名称	灿芯半导体（上海）股份有限公司
公司性质	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人	ZHIQING JOHN ZHUANG（庄志青）
注册资本	9,000 万人民币
成立日期	2008 年 7 月 17 日
住所/主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 6 楼
主营业务	集成电路的设计、研发，软件的研发、制作，销售自产产品，并提供相关技术咨询和技术服务，上述同类产品的批发佣金代理（拍卖除外）。
主要股东或实际控制人	中芯国际控股有限公司；持股比例 18.98% NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP；持股比例 13.47% 嘉兴君椒投资合伙企业（有限合伙）；持股比例 5.93% BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC；持股比例 5.43%

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 6 月起，该公司不再是公司关联方。
2	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	过去 12 个月，公司前任董事长高永岗博士在该公司担任董事长，自 2024 年 8 月起，该公司不再是公司关联方。
3	凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司副董事长
4	灿芯半导体（上海）股份有限公司	公司联合首席执行官赵海军担任该公司董事长

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、晶圆代工及资产租赁等内容，交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与盛吉盛（宁波）半导体科技有限公司签署了 2 份《租赁合同》，向盛吉盛出租场地用作办公用房，协议期限分别为 2021 年 7 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日、2023 年 4 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。中芯国际集成电路制造（北京）有限公司与盛吉盛签署了《租赁合同》、《办公室/工位租赁协议》，出租办公室给盛吉盛使用，协议期限分别为 2021 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 30 日、2022 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

2、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司签署了《租赁合同》及《办公室租赁合同》，向中芯聚源出租场地用作办公用房，协议期限分别为 2023 年 11 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日、2022 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。中芯晶圆股权投资（上海）有限公司与中芯聚源签署了《委托管理协议》及补充协议，委托中芯聚源管理其资产，协议期限为 2019 年 9 月 5 日至 2029 年 2 月 26 日。

3、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、以及控股子公司中芯南方集成电路制造有限公司、中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司分别与灿芯半导体（上海）股份有限公司签署了《芯片代工协议》，协议期限分别为 2022 年 5 月 4 日至 2027 年 5 月 3 日、2021 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 16 日、2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日、2020 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日、2021 年 6 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日。

4、公司全资子公司中芯国际集成电路制造（上海）有限公司与凸版迪色丝电子传感器（上海）有限公司签署了《租赁合同》的补充协议，向凸版出租厂房的期限延至 2026 年 7 月 31 日。

除已签署协议外，公司与上述关联方将在董事会书面决议通过 2024 年度日常关联交易额度预计事项后，根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构海通证券、中金公司认为：

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》、《关联（连）交易管理制度》等相关规定；本次关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。联合保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

A 股代码：688981　　A 股简称：中芯国际　　公告编号：2024-006

港股代码：00981　　港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278 号）的批准，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 193,846.30 万股（含超额配售选择权），发行价格人民币 27.46 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 5,323,019.40 万元，扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为人民币 5,253,820.15 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 14 日及 8 月 17 日分别出具了普华永道中天验字[2020]第 0590 号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第 0739 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15
减：支付发行费用	2,259.43
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	449,445.27
减：募投项目累计支出金额	4,843,167.20
减：募集资金账户销户利息转出	21.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,072.95
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于 2023 年 12 月 31 日前完成全部募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020 年 7 月 7 日及 2020 年 8 月 21 日，公司与联合保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金（针对超额配售）专户存储四方监管协议》。2021 年 4 月 7 日及 2021 年 4 月 26 日，公司与海通证券、中金公司分别同中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。针对不同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续，上述募集资金监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额列示如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（人民币万元）	备注
招商银行上海分行营业部	NRA110925662010101	活期存款	0.00	已销户
招商银行上海分行营业部	NRA110925662032501	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471584	活期存款	0.00	已销户
民生银行上海金桥支行	630984295	活期存款	0.00	已销户
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	0.00	已销户
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196131	活期存款	0.00	已销户
浦发银行上海虹桥支行	98860078801300001507	活期存款	0.00	已销户
FT 农行上海金桥支行国际部	FTN097781000048500217	活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN000009907	活期存款	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年 8 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》，同意公司利用超募资金中的人民币 1,000,000.00 万元、人民币 500,000.00 万元、人民币 300,000.00 万元分别用于 12 英寸芯片 SN1 项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

2020 年 8 月 6 日，公司召开董事会会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案，董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况，并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件，以及提交任何必要的文件，并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动（包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告）。2020 年 8 月 14 日，联席公司秘书代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择